

中证网讯（记者 王可）4月20日，国内领先的高端先进封测龙头企业——合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“颀中科技”，股票代码“688352”）正式登陆科创板，保荐人和主承销商为中信建投证券。

公司表示，自成立以来，颀中科技即定位于集成电路的先进封装业务，是境内少数掌握多类凸块制造技术并实现规模化量产的集成电路封测厂商，也是境内最早专业从事8吋及12吋显示驱动芯片全制程（Turn-key）封测服务的企业之一。经过近二十年的发展，颀中科技现已形成以显示驱动芯片封测业务为主，电源管理芯片、射频前端芯片等非显示类芯片封测业务齐头并进的良好格局。

### 技术指标行业领先

受制于技术与开发成本的双重难关，通过先进封装技术提升芯片整体性能成为了集成电路行业技术发展趋势。集成电路凸块制造技术作为现代先进封装的核心技术之一，也是诸多先进封装技术得以实现和进一步演化的基础。

对此，颀中科技经过多年的研发积累和技术攻关，在集成电路凸块制造、测试以及后段封装环节上掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术和大量先进工艺。以金凸块制造为例，颀中科技通过在晶圆表面制作数百万个极其微小的金凸块作为芯片封装的引脚，极大地提升了显示驱动芯片的性能。

除此以外，颀中科技在铜镍金凸块、铜柱凸块、锡凸块等其他凸块制造技术上也取得了丰硕的研发成果，开发出多项核心技术，覆盖了整个生产制程，为公司产品保持较高竞争力提供了坚实保障。

作为一家高新技术企业，截至2022年6月末，颀中科技已取得73项授权专利，其中发明专利35项、实用新型专利38项。与境内外同行业可比公司对比来看，颀中科技在凸块制造、晶圆测试及后段封装等主要工艺环节所涉及的关键技术指标上均处于领先或持平水平，在品质管控方面亦然领先于行业，各主要生产环节的生产良率稳定在99.95%以上。

### 主营业务增长强劲

历经近二十年的持续深耕，颀中科技在巩固显示驱动芯片封测领域优势地位的同时，也于2015年将业务版图扩展至非显示类芯片封测市场。目前，颀中科技封装的非显示类产品主要以电源管理芯片、射频前端芯片（功率放大器、射频开关、低噪放等）为主，少部分为MCU（微控制单元）、MEMS（微机电系统）等其他类型芯片，广泛应用于消费类电子、通讯、家电、工业控制等下游领域。

据颀中科技介绍，凭借多年来在业务版图及产品布局的持续拓展，以及在产品质量、专业服务等方面的优异表现，在显示驱动芯片封测领域，颀中科技积累了联咏科技、敦泰电子、奇景光电、瑞鼎科技、谱瑞科技、晶门科技、集创北方、奕斯伟计算、云英谷等境内外知名客户；在非显示驱动芯片封测领域，公司开发了矽力杰、杰华特、南芯半导体、艾为电子、唯捷创芯、希荻微等优质客户资源。根据沙利文数据，2020年中国前十大显示驱动芯片设计企业中有九家是公司客户。

业绩方面，2019年至2021年，颀中科技显示驱动芯片封测业务收入分别为6.42亿元、8.06亿元、11.99亿元。根据赛迪顾问及沙利文数据测算，2019年至2021年，颀中科技是境内收入规模最大、出货量最大的显示驱动芯片封测企业，在全球显示驱动芯片封测领域位列第三名。同时，公司非显示类芯片封测业务收入持续增加，由2019年的1310.67万元增长至2021年的10084.42万元，三年复合增长率达177.38%。

### 未来成长前景广阔

近年来，随着摩尔定律持续推进引发的经济和性价比效益下滑，叠加5G、物联网和人工智能等新兴趋势的共同推动，以3D、Sip、Chiplet等为代表的先进封装技术发展快速。根据Yole数据，全球先进封装市场规模有望在2027年达650亿美元，2021-2027年复合年均增长率约9.6%。后摩尔时代，先进封装作为实现“超越摩尔定律”的重要方式，其成长性优于整体封装市场和传统封装市场，从整个封装行业来看，先进封装占比加速提升，有望在2026年超过50%。

封测环节已成为国内半导体产业中最具竞争力的环节，国内封测厂商也在半导体全球测试市场中占据主导地位。据中国半导体行业协会统计及Frost&Sullivan数据，预计2025年，国内封测产业市场规模有望达3551.9亿元，约占全球市场的75.61%

。